

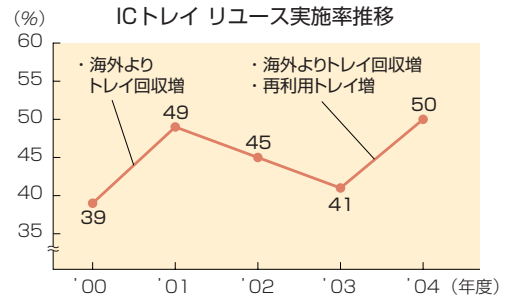
# 環境活動内容

## 資源のミニマム化

資源のミニマム化として、電子部品の梱包材リユース、梱包方法改善による資源削減並びに使用済みの梱包材(廃棄物)のリサイクル等で継続的な省資源化を実行しています。

### ■ 梱包材のリユース

ICチップ製造工場からIC組立て工場に搬送する際にICチップ専用トレイを使用しています。その専用トレイを回収し清掃、変形等を確認し、リユースを図っています。



### ■ 梱包資材削減

製品梱包におけるウレタン系緩衝材をダンボール材に変更し、紙系包装資材に統一を図る。また、二重梱包箱を廃止し、個装箱を直接パレットに積み込むことで、省資源化を図っています。

#### ウレタンの緩衝材⇒ダンボールパットへ包装仕様変更



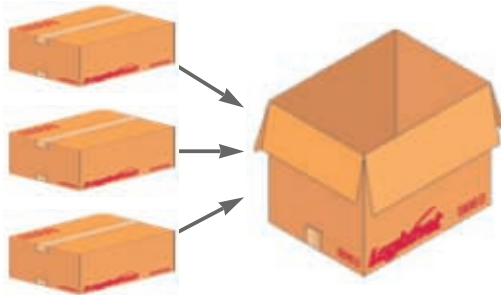
《改善前》  
WCM光PKG  
(ウレタン仕様)



《改善後》  
WCM光PKG  
(ダンボールパット仕様)

#### 二重ダンボール梱包のシングル化による包装資材削減

《改善前》  
内装ダンボール梱包と外装ダンボール梱包で二重梱包。



《改善後》  
内装ダンボール梱包後、通いパレットに直接積み込み。

